

# 精材科技股份有限公司

## 民國 114 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 114 年 5 月 29 日（星期四）上午 9 時

地點：桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓

本公司已發行股份總數：271,364,316 股

出席股東(含電子投票)及代理人所持股數：156,780,727 股

出席股數占全部已發行股數：57.77%

出席董事：陳家湘董事長(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)、謝徽榮獨立董事(審計委員會召集人)、王文宇獨立董事(薪酬委員會召集人)

主 席：陳家湘董事長

紀 錄：林恕敏

### 壹、宣布開會

出席股東代表數已達法定數，主席宣佈開會。

### 貳、主席致詞(略)

### 參、報告事項

一、113 年度營業報告(請參閱附件一)。

二、審計委員會查核報告(請參閱附件二)。

三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1.本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞業經 114 年 2 月 6 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

2.員工現金酬勞共計新台幣 267,994,306 元，董事酬勞及報酬共計新台幣 6,048,000 元(包括獨立董事報酬新台幣 4,032,000 元)。

3.員工酬勞及董事酬勞估列金額與分派金額無差異。

四、113 年度董事酬金領取內容報告。

說明：1.本公司董事之酬金係依本公司「章程」及「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。

2.公司章程中亦明訂本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括兼任經理人之董事。

3. 113 年度董事酬金領取內容請參閱附表。

以上報告案均無股東提問

肆、承認事項

一、案由：承認113年度之營業報告書及財務報表。(董事會提)

- 說明：(一) 本公司民國 113 年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞及黃裕峰會計師查核完竣。
- (二) 民國 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。
- (三) 敬請 承認。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 156,780,727 權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數
贊成權數	16,573,752	138,958,342	155,532,094	99.20%
反對權數	0	18,085	18,085	0.01%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	7,400	1,223,148	1,230,548	0.78%

本案照原案表決通過。

(註：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比例係採無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%)

二、案由：承認113年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一) 113 年度盈餘分派案，業經 114 年 2 月 6 日董事會決議通過，考量 113 年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 678,410,790 元(普通股現金股利每股配發新台幣 2.5 元)為股東股利。現金股利發放至元為止(元以下捨去不計)，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。本案授權董事長俟股東常會通過後另訂除息基準日等相關事宜，嗣後如因本公司股本發生變動，影響本公司流通在外股份總數，致股東配息率因

此發生變動者，請授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按分配股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。

(二) 民國 113 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 156,780,727 權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數
贊成權數	16,573,752	138,959,387	155,533,139	99.20%
反對權數	0	25,615	25,615	0.01%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權 / 未投票權數	7,400	1,214,573	1,221,973	0.77%

本案照原案表決通過。

(註：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比例係採無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%)

#### 伍、討論事項

案由：核准修訂本公司「公司章程」。(董事會提)

說明：(一) 依修正後之「證券交易法」第14條第6項規定，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。考量現況後，本公司修訂章程第27條增列「基層員工酬勞分派或調整薪資應不低於員工酬勞總額的百分之十。」。

(二) 因本公司「董事會議事規則」第15條第3項已有「董事會簽到簿保存期間」之規定，故刪除公司章程第21條「出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年」，及修訂第30條修訂歷程。

(三)「公司章程」修訂對照表，請參閱附件五。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數156,780,727權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數

贊成權數	16,573,752	138,869,058	155,442,810	99.14%
反對權數	0	17,212	17,212	0.01%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權 / 未投票權數	7,400	1,313,305	1,320,705	0.84%

本案照原案表決通過。

(註：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比例係採無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%)

## 陸、選舉事項

案由：董事改選案。(董事會提)

說明：(一) 本公司現任董事任期於114年5月25日屆滿，依法於本次股東常會改選，依本公司章程及董事會決議應選6席董事(含獨立董事4席)，任期自114年5月29日起至117年5月28日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(二) 依公司章程第15條規定，本公司董事之選舉，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事會業於114年4月15日完成董事(含獨立董事)候選人資格審查，董事(含獨立董事)候選人之學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

(三) 敬請 選舉。

議事經過：本案無股東提問

選舉結果：出席股東投票選出6席董事(含獨立董事4席)，當選之第十一屆董事任期為三年，自114年5月29日至117年5月28日止。董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

董事：

股東戶號 或身份證號	戶名或姓名	當選權數
00001532	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：陳家湘	138,520,468
00001532	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：游秋山	137,305,204

獨立董事：

股東戶號 或身份證號	戶名或姓名	當選權數
C22082****	李雨師	135,758,507

股東戶號 或身份證號	戶名或姓名	當選權數
A10338****	王文宇	135,042,047
A10395****	謝徽榮	136,367,711
T12111****	梁明成	135,363,713

## 柒、其他議案

案由：核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。(董事會提)

說明：(一) 依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二) 爰依法提請股東常會同意於董事說明其行為之重要內容後，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容，請參閱附件七。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數156,780,727權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表 決權數
贊成權數	16,573,752	136,762,675	153,336,427	97.80%
反對權數	0	212,824	212,824	0.13%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投 票權數	7,400	3,224,076	3,231,476	2.06%

本案照原案表決通過。

(註：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比例係採無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%)

## 捌、臨時動議

(因股東之提問與前述議案無關，故以摘要方式記載及簡述回覆如下。)

戶號 155991 股東提問：請公司就設備攤提年限、台幣升值影響及台積占營收比重進行說明。

主席或其指定之人回覆：生產設備攤提年限為5年、廠房為35年、廠務設施與無塵室為8~10年。而公司營收均為美金報價，台幣升值將使營收減少，另

生產成本主要為台幣，故能抵減的金額有限。此外，公司持續關注關稅議題對終端需求的影響，倘若未來需求轉弱，是有可能影響營收與獲利。113 年台積訂單占精材營收約 75%。

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

玖、散會



---

主 席：陳 家 湘



---

紀 錄：林 恕 敏

單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及稅後純益之比例		有無來自子公司以外轉投資或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	1,008	1,008	120	120	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	5,348	5,348	0	0	5,540	0	5,540	0	12,016 / 0.72%	12,016 / 0.72%	無
董事	汪業傑 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	859	859	110	110	969 / 0.06%	969 / 0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0	969 / 0.06%	969 / 0.06%	無
董事	游秋山 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	149	149	20	20	169 / 0.01%	169 / 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	169 / 0.01%	169 / 0.01%	無
獨立董事	王文宇	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	無
獨立董事	謝徽榮	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	無
獨立董事	溫瓊岸	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	無
獨立董事	梁明成	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.07%	1,128 / 0.07%	無

\*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：法人董事於113年11月8日改派代表人為游秋山先生，原法人代表汪業傑於113年11月7日辭任董事。

註2：陳家湘、汪業傑及游秋山為台積公司代表人，董事酬勞係由其所代表之法人股東領取。

註3：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。

本公司給付獨立董事每人每月報酬及車馬費。

註4：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

## 精材科技股份有限公司 民國 113 年度營業報告書

113 年企業多面臨全球高通膨壓力，使得營運成本難以抑制並持續上揚。公司處在眾多挑戰的大環境中，謹慎地依計畫持續向前。回顧 113 年，公司在主要營收部分如影像感測器封裝與 12 吋晶圓測試皆有雙位數成長，3D 感測零組件加工營收也優於前一年度表現，整體獲利優於預期。

### 經營實績

精材公司 113 年全年營收為新台幣 70.6 億元，較前一年營收增加 10.5%。淨利為新台幣 16.7 億元，較前一年度增加 21.4%。每股淨利為新台幣 6.15 元。財務收支及獲利能力分析如下：

單位:新台幣百萬元

分析項目		113年度	112年度	增減比率	
財務 收支	營業收入	7,060	6,387	10.5%	
	營業毛利	2,493	2,179	14.4%	
	稅後淨利	1,670	1,376	21.4%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	14.66%	14.16%	0.5%	
	股東權益報酬率(%)	19.59%	17.93%	1.7%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	72.81%	62.83%	10.0%
		稅前利益	75.93%	64.51%	11.4%
	純益率(%)	23.65%	21.54%	2.1%	
稅後基本每股盈餘(元)	6.15	5.07	21.3%		

### 技術與創新

113 年度持續引進新機台與開發新製程。12 吋封裝與加工所需的各項技術已經逐步建立，除了將既有的各項 8 吋技術延展至 12 吋之外，也針對市場趨勢與特定客戶需求，開發各項 12 吋晶圓級封裝技術。

目前已經針對 12 吋客戶提供數項專案開發與技術服務，包括客製化晶圓級封裝應用於 AR/VR 相關領域、車用影像感測器客製化加工服務、穿戴式裝置感測器之超薄晶圓級封裝等，各項新技術將陸續於 114 年起逐步量產。精材科技的各項 12 吋技術提供高良率、微型化封裝等附加價值，協助客戶提升市場競爭力。

下個世代封裝的重點在於異質結合與微型化整合。公司針對所需先進技術，陸續投資所需設備，如晶圓級模封 (Molding)、穿孔導線 (TMV, Through Molding Via)、晶粒與晶圓接合設備 (C2W, chip to wafer bond) 等，以加速開發 SiP 晶圓級封裝 (System in WL CSP)。

### 企業治理與社會責任

永續經營，善盡社會責任一直是精材對股東及社會的承諾。公司去年如期達成年度推行「123 專案」，節能減碳 1%、減少廢棄物 2%、降低用水 3% 的環境管理目標，對於再生

能源使用計畫，今年將再增購 100 萬度，達每年約 300 萬度的再生能源，公司將持續投入資源於節能減廢，朝環境永續目標邁進。

公司通過責任商業聯盟 (RBA) 的稽核認證及職安衛相關認證，堅持建構尊重人權、多元、平等、包容、安全與環保的工作環境，舉辦廠區愛心義賣、募集物資及善款捐助弱勢團體，讓愛走進社會已是精材同仁熱心參與公益的日常，去年相關金額超過新台幣 120 萬元。

公司已累計 7 次榮獲櫃檯買賣中心「公司治理評鑑」排名前 5% 榮耀，期望透過全體同仁的持續努力，利益關係人的信任與客戶的支持，精材持續善盡企業應有的社會責任。

### 前景與展望

展望 114 年，整體半導體業除了 AI 相關產業，其餘仍多偏保守看待。我們必須持續建構先進封裝技術，提供有利基、差異化的晶圓級 CSP 服務，除增加既有車用影像感測 (CIS) 產出，也因應客戶新產品設計需求，提供各式客製化加工及封裝服務。新的應用包括醫療、AR/VR 等相關光學感測器。同時公司正加速中長期技術研發與設備投資，如感測器相關之 SiP 晶圓級封裝，期許儘速完備技術能力驗證，以隨時迎接各種成長契機。

對策略客戶提供之 12 吋晶圓級測試服務，按原定計劃於第一季開始在中國路新廠房進行裝機，將逐季貢獻營收。此外，服務範圍也會擴展到成品最終測試(Final Test)。

最後，感謝各位股東長期對精材科技的支持與信任。

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏



## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第十四條之五及公司法第二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

精材科技股份有限公司



審計委員會召集人： 謝徽榮



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 六 日

會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

精材科技股份有限公司（以下簡稱精材公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與精材公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對精材公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對精材公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

精材公司主要收入為封裝服務收入及測試服務收入，對財務報告之影響係屬重大。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報告附註四、五及二十。本會計師針對本年度銷售較前一年度顯著成長之特定客戶，對其相關收入認列真實性列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並抽樣測試特定客戶之訂單程序、出貨程序、銷貨收入認列與收款等相關內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 抽樣檢視該等客戶之訂單、相關出貨單據，確認銷貨收入變化之真實性。
3. 抽樣檢視該特定客戶之收款情形，並核對實際收款金額及匯款證明是否相符；尚未收款者則檢視是否在授信期間內，如已逾授信期間則進一步了解有無異常情事。

#### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精材公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算精材公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

精材公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報表之責任**

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對精材公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使精材公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致精材公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對精材公司民國 113 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



會計師 黃 裕 峰

黃 裕 峰



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 6 日

精材科技股份有限公司  
資產負債表  
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 5,035,697	39	\$ 3,719,965	37	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	\$ 8,421	-	\$ -	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	-	-	20,932	-	2170	應付帳款	159,983	1	155,227	2
1140	合約資產 (附註二十及三二)	247,150	2	175,769	2	2201	應付薪資及獎金	188,197	2	176,553	2
1170	應收帳款淨額 (附註八)	215,772	2	178,461	2	2206	應付員工及董事酬勞 (附註二七)	270,010	2	229,004	2
1180	應收關係人款項淨額 (附註八及三一)	987,992	8	1,020,153	10	2213	應付工程及設備款	675,871	5	217,275	2
1310	存貨 (附註五及九)	194,306	1	211,195	2	2230	本期所得稅負債 (附註二五)	223,038	2	240,333	2
1476	其他金融資產	4,216	-	4,286	-	2280	租賃負債-流動 (附註十一及二九)	38,598	-	39,507	-
1479	其他流動資產 (附註十三及三一)	80,207	1	54,458	1	2399	應付費用及其他流動負債 (附註十六及三一)	445,444	4	411,597	4
11XX	流動資產合計	6,765,340	53	5,385,219	54	21XX	流動負債合計	2,009,562	16	1,469,496	14
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十及三二)	5,768,982	45	4,341,020	44	2540	長期借款 (附註十四)	1,188,415	9	-	-
1755	使用權資產 (附註十一)	166,733	1	208,335	2	2550	負債準備 (附註十五)	390,151	3	404,913	4
1780	無形資產 (附註十二)	14,532	-	20,784	-	2580	租賃負債-非流動 (附註十一及二九)	133,266	1	172,609	2
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	83,863	1	22,300	-	2600	其他非流動負債 (附註十四及十七)	17,585	-	-	-
1920	存出保證金	11,834	-	14,260	-	25XX	非流動負債合計	1,729,417	13	577,522	6
1975	淨確定福利資產 (附註十八)	18,721	-	9,247	-	2XXX	負債合計	3,738,979	29	2,047,018	20
15XX	非流動資產合計	6,064,665	47	4,615,946	46		權益 (附註十九)				
							股本				
						3110	普通股股本	2,713,643	21	2,713,643	27
						3200	資本公積	396,424	3	396,424	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	715,068	6	577,261	6
						3350	未分配盈餘	5,265,891	41	4,266,819	43
						3300	保留盈餘合計	5,980,959	47	4,844,080	49
						3XXX	權益合計	9,091,026	71	7,954,147	80
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,830,005	100	\$ 10,001,165	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 12,830,005	100	\$ 10,001,165	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘

經理人：陳家湘

會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二十及三一）	\$ 7,059,941	100	\$ 6,386,868	100
5000	營業成本（附註九、二七及三一）	<u>4,567,013</u>	<u>65</u>	<u>4,207,658</u>	<u>66</u>
5950	營業毛利	<u>2,492,928</u>	<u>35</u>	<u>2,179,210</u>	<u>34</u>
	營業費用（附註二七）				
6100	行銷費用	55,744	-	50,595	1
6200	管理費用	129,725	2	122,021	2
6300	研究發展費用	<u>411,971</u>	<u>6</u>	<u>369,092</u>	<u>5</u>
6000	合 計	<u>597,440</u>	<u>8</u>	<u>541,708</u>	<u>8</u>
6500	其他營業收益及費損淨額 （附註二一、二七及三一）	<u>80,215</u>	<u>1</u>	<u>67,590</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>1,975,703</u>	<u>28</u>	<u>1,705,092</u>	<u>27</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	62,967	1	49,242	1
7050	財務成本（附註二三）	( 5,158)	-	( 4,093)	-
7020	其他利益及損失（附註二四）	<u>26,862</u>	<u>-</u>	<u>261</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>84,671</u>	<u>1</u>	<u>45,410</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	2,060,374	29	1,750,502	28
7950	所得稅費用（附註二五）	( <u>390,654</u> )	( <u>5</u> )	( <u>374,728</u> )	( <u>6</u> )
8200	本年度淨利	<u>1,669,720</u>	<u>24</u>	<u>1,375,774</u>	<u>22</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 八)	<u>9,887</u>	<u>-</u>	<u>2,289</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	<u>9,887</u>	<u>-</u>	<u>2,289</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,679,607</u>	<u>24</u>	<u>\$ 1,378,063</u>	<u>22</u>
	每股盈餘(附註二六)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 6.15</u>		<u>\$ 5.07</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.12</u>		<u>\$ 5.03</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏





精材科技股份有限公司  
權益變動表  
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘			權 益 合 計
		股 數 ( 仟 股 )	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ 378,452	\$ 3,901,658	\$ 4,280,110	\$ 7,390,177
B1	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	198,809	( 198,809)	-	-
B5	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	( 814,093)	( 814,093)	( 814,093)
D1	112 年 度 淨 利	-	-	-	-	1,375,774	1,375,774	1,375,774
D3	112 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	2,289	2,289	2,289
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	1,378,063	1,378,063	1,378,063
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	271,364	2,713,643	396,424	577,261	4,266,819	4,844,080	7,954,147
B1	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	137,807	( 137,807)	-	-
B5	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	( 542,728)	( 542,728)	( 542,728)
D1	113 年 度 淨 利	-	-	-	-	1,669,720	1,669,720	1,669,720
D3	113 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	9,887	9,887	9,887
D5	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	1,679,607	1,679,607	1,679,607
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ 715,068	\$ 5,265,891	\$ 5,980,959	\$ 9,091,026

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 2,060,374	\$ 1,750,502
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	587,198	651,866
A20200	攤銷費用	15,180	15,254
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	41	( 69)
A20900	財務成本	5,158	4,093
A21200	利息收入	( 62,967)	( 49,242)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	( 17,687)	( 3,728)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	10,146	5,708
A29900	除役成本利益	( 537)	-
A29900	租賃修改損失	395	-
A24100	外幣兌換淨損（益）	2,952	( 1,444)
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	29,353	( 21,555)
A31125	合約資產	( 71,403)	( 15,027)
A31150	應收帳款淨額	( 37,330)	69,289
A31160	應收關係人款項淨額	32,161	27,222
A31200	存 貨	6,743	57,083
A31240	其他流動資產	( 25,749)	( 2,815)
A31250	其他金融資產	1,771	( 1,765)
A32150	應付帳款	4,756	( 18,554)
A32180	應付員工及董事酬勞	41,006	( 96,883)
A32180	應付薪資及獎金	11,644	39,688
A32200	負債準備	( 18,537)	-
A32230	應付費用及其他流動負債	33,127	( 19,860)
A32240	淨確定福利資產／負債	413	( 93)
A33000	營運產生之現金	2,608,208	2,389,670
A33500	支付所得稅	( 469,512)	( 501,811)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,138,696</u>	<u>1,887,859</u>
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 1,514,445)	( 866,334)
B02800	處分不動產、廠房及設備	17,687	3,728

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
B03700	存出保證金增加	( 1,166)	( 3,692)
B03800	存出保證金減少	3,592	1,300
B04500	購置無形資產	( 8,928)	( 4,775)
B07500	收取之利息	<u>61,266</u>	<u>48,361</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,441,994)</u>	<u>( 821,412)</u>
	籌資活動之現金流量：		
C01600	舉借長期借款	1,206,000	-
C04020	租賃本金償還	( 39,534)	( 39,065)
C04500	發放現金股利	( 542,728)	( 814,093)
C05600	支付之利息	<u>( 4,708)</u>	<u>( 3,474)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>619,030</u>	<u>( 856,632)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	1,315,732	209,815
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,719,965</u>	<u>3,510,150</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,035,697</u>	<u>\$ 3,719,965</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司

盈餘分派表

民國113年度

民國一一三年度純益	<b>NT\$1,669,720,474</b>
加:確定福利計劃之再衡量數	9,886,453
民國一一三年度未分配盈餘	<b>NT\$1,679,606,927</b>
減:提撥百分之十法定盈餘公積	(167,960,693)
加:以前年度未分配保留盈餘	3,586,284,167
截至民國一一三年底可分配盈餘	<b>NT\$5,097,930,401</b>
分派項目:	
減:普通股現金股利(每股新台幣2.5元)	(678,410,790)
期末未分配盈餘	<b>NT\$4,419,519,611</b>

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司  
「公司章程」修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第廿一條：</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。<del>出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。</del></p>	<p>第廿一條：</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。</p>	<p>依法修訂。</p>
<p>第廿七條：</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。<u>基層員工酬勞分派或調整薪資應不低於員工酬勞總額的百分之十。</u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或</p>	<p>第廿七條：</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公</p>	<p>依法修訂。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本條第一項有關員工酬勞部份，其對象得包括控制及從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。</p> <p>本條第一項之「獲利」係指稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>	<p>積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本條第一項有關員工酬勞部份，其對象得包括控制及從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。</p> <p>本條第一項之「獲利」係指稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>	
<p>第卅條： 本章程訂立於中華民國八十七年六月十六日。 第一次修正於中華民國八十九年七月二十五日。 第二次修正於中華民國九十年七月二十四日。 第三次修正於中華民國九十一年六月二十八日。 第四次修正於中華民國九十二年一月十日。 第五次修正於中華民國九十二年六月二十七日。 第六次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第七次修正於中華民國九十四年六月二十九日。 第八次修正於中華民國九十五年六月十六日。 第九次修正於中華民國九十五年十二月五日。 第十次修正於中華民國九十六年三月五日。 第十一次修正於中華民國九十</p>	<p>第卅條： 本章程訂立於中華民國八十七年六月十六日。 第一次修正於中華民國八十九年七月二十五日。 第二次修正於中華民國九十年七月二十四日。 第三次修正於中華民國九十一年六月二十八日。 第四次修正於中華民國九十二年一月十日。 第五次修正於中華民國九十二年六月二十七日。 第六次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第七次修正於中華民國九十四年六月二十九日。 第八次修正於中華民國九十五年六月十六日。 第九次修正於中華民國九十五年十二月五日。 第十次修正於中華民國九十六年三月五日。 第十一次修正於中華民國九十</p>	<p>敘明本章程修訂歷程。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>六年六月七日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十八年六月四日。</p> <p>第十三次修正於中華民國一百年六月十六日。</p> <p>第十四次修正於中華民國一百零一年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於中華民國一百零二年六月十三日。</p> <p>第十六次修正於中華民國一百零四年六月十六日。</p> <p>第十七次修正於中華民國一百零五年六月十四日。</p> <p>第十八次修正於中華民國一百零八年五月三十日。</p> <p><u>第十九次修正於中華民國一百一十四年五月二十九日。</u></p>	<p>六年六月七日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十八年六月四日。</p> <p>第十三次修正於中華民國一百年六月十六日。</p> <p>第十四次修正於中華民國一百零一年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於中華民國一百零二年六月十三日。</p> <p>第十六次修正於中華民國一百零四年六月十六日。</p> <p>第十七次修正於中華民國一百零五年六月十四日。</p> <p>第十八次修正於中華民國一百零八年五月三十日。</p>	

## 董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
董事	台灣積體 電路製造 股份有限 公司 代表人： 陳家湘	<u>學歷</u> 國立交通大學光電工程研究所碩士 國立交通大學電子物理系學士  <u>經歷</u> 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司先進封測三廠資深處長 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 台積公司七廠廠長 台積公司產品工程處處長  <u>現任職務</u> 本公司董事長暨總經理及 ESG 指導委員會召集人
持有股數：111,281,925 股		

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
董事	台灣積體 電路製造 股份有限 公司 代表人： 游秋山	<u>學歷</u> 美國伍斯特理工學院化學工程博士  <u>經歷</u> 台積公司歐亞業務副總經理 台積公司歐亞業務策略客戶專案辦公室資深處長 台積公司電子束作業處資深處長 台積公司 SRAM/DRAM/嵌入式 DRAM 開發處副處長  <u>現任職務</u> 台積公司特殊技術組織副總經理
持有股數：111,281,925 股		

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
獨立董事	李雨師	<p><u>學歷</u> 政治大學企業管理博士</p> <p><u>經歷</u> 中原大學領導力發展中心暨 EMBA 副執行長 中原大學公共事務中心主任 中原大學企業管理學系助理教授</p> <p><u>現任職務</u> 中原大學學生事務處副學務長 中原大學企業管理學系副教授</p>
持有股數：0 股		

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
獨立董事	王文宇	<p><u>學歷</u> 美國史丹福大學法學博士</p> <p><u>經歷</u> 創意電子公司獨立董事 凱基證券獨立董事 統一超商公司獨立董事 臺灣大學法律學院教授 行政院公平交易委員會委員</p> <p><u>現任職務</u> 本公司獨立董事、薪酬委員會召集人 尼得科超眾科技獨立董事 臺灣大學法律學院兼任教授 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人 開南大學法律學院客座教授兼院長</p>
持有股數：0 股		
<p><b>獨立董事任期達三屆者之提名理由</b> 王文宇先生擁有豐富的法律及產官學經驗，本公司需借重其法律專業及經驗對公司治理、法規遵循等事項提出建議。董事會相信王文宇先生具有獨立性及公正判斷執行職務之能力。</p>		

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
獨立董事	謝徽榮	<p><b>學歷</b> 國立臺灣大學商研所碩士 國立清華大學核子工程系學士</p> <p><b>經歷</b> 寶勝國際(控股)有限公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席 茂達電子股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理 美商美國銀行副總經理</p> <p><b>現任職務</b> 本公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及 ESG 指導委員會委員</p>

持有股數：0 股

**獨立董事任期達三屆者之提名理由**

謝徽榮先生擁有豐富財務及會計領域專業能力及相關經驗，本公司需借重其財務及會計專業及經驗對公司治理、法規遵循等事項提出建議。董事會相信謝徽榮先生具有獨立性及公正判斷執行職務之能力。

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
獨立董事	梁明成	<p><b>學歷</b> 國立台灣大學國際企業學研究所 EMBA 碩士 國立成功大學物理系學士</p> <p><b>經歷</b> 台灣光罩集團美祿科技董事 台灣光罩集團群豐科技董事 建騰創達科技獨立董事 昇陽半導體獨立董事 美光科技副總裁</p> <p><b>現任職務</b></p>

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
		本公司獨立董事及 ESG 指導委員會委員 昇陽半導體董事長
持有股數：0 股		

## 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容

職稱	姓名	經營業務或現任職務
董事	台灣積體電路製造股份有限公司	<p>CC01080 電子零組件製造業</p> <p>1.依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。</p> <p>提供前述產品之封裝與測試服務。</p> <p>提供積體電路之電腦輔助設計技術服務。</p> <p>提供製造光罩及其設計服務。</p> <p>上述公司所營部分項目為 CC01080 電子零組件製造業等產品之製造、封裝及測試，與本公司相同。</p>
	代表人：游秋山	<p>台積公司特殊技術組織副總經理</p> <p>上述公司所營部分項目為 CC01080 電子零組件製造業等產品之製造、封裝及測試，與本公司相同。</p>
獨立董事	梁明成	<p>昇陽國際半導體股份有限公司董事長</p> <p>上述公司所營部分項目為 CC01080 電子零組件製造業，與本公司相同。</p>
獨立董事	王文字	<p>尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事</p> <p>上述公司所營部分項目為 CC01080 電子零組件製造業、F113010 機械批發業、F119010 電子材料批發業，與本公司相同。</p>